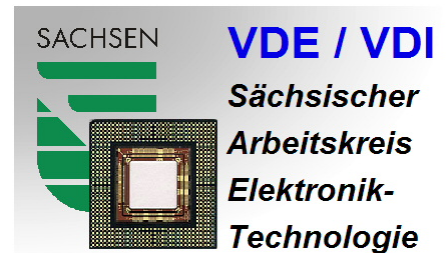


Obmann: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Bauer  
Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (FH)  
01069 Dresden  
e-mail: [bauer@et.htw-dresden.de](mailto:bauer@et.htw-dresden.de)

Koordinierung: Dr.-Ing. Martin Oppermann  
Technische Universität Dresden  
Zentrum für mikrotechnische Produktion  
01062 Dresden  
e-mail: [oppermann@zmp.et.tu-dresden.de](mailto:oppermann@zmp.et.tu-dresden.de)



Informationen zum Arbeitskreis im Internet:

<http://www.avt.et.tu-dresden.de/SAET/>

## **39. Treffen des Sächsischen Arbeitskreises Elektronik-Technologie**

**Thema:** *Nacktchipmontage und Löten beim Microelectronic Packaging*

**Gastgeber:** Microelectronic Packaging Dresden GmbH ([www.mpd.de](http://www.mpd.de))

**Ort:** Grenzstraße 24, 01109 Dresden

**Datum:** 24. März 2004 10:00 Uhr

### **Agenda:**

- 10:00 Uhr Begrüßung  
*Herr Ludewig – MPD, Herr Prof. Bauer – HTW*
- 10:05 Uhr Vorstellung der Fa. Microelectronic Packaging Dresden GmbH  
*Herr Pulver – MPD*
- 10:30 Uhr Aktuelle Trends und Anforderungen des Microelectronic Packagings  
*Herr Schneider – MPD*
- 11:15 Uhr *Kaffeepause*
- 11:30 Uhr Vollautomatisierte Reworkprozesse  
*Herr Sommerfeld, Herr Pietrzak – ZEVAC GmbH, Oberpfammern*
- 12:15 Uhr *Mittagspause*
- 13:00 Uhr Neuigkeiten aus der Röntgentechnik - von 2D bis Tomographie  
*Herr Sommerfeld, Herr Pietrzak – ZEVAC GmbH, Oberpfammern*
- 13:30 Uhr Löten auf Packaging-Niveau  
*Herr Schneider – MPD*
- 14:00 Uhr Einsatz eines UV-Inspektionsgerätes für organische Schichtmaterialien in der Mikroelektronik  
*Herr Ronniger – KARO Electronics Vertriebs GmbH, Dorfen*
- 14:30 Uhr Abschlussdiskussion und Organisatorisches  
*Herr Prof. Bauer – HTW, Herr Dr. Oppermann – TUD*
- 14:45 Uhr *Fertigungsbesichtigung MPD*

Alle Interessenten sind herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen. Anmeldungen sind bis eine Woche vor der Veranstaltung an Herrn Prof. Bauer oder Herrn Dr. Oppermann (Email-Adressen: siehe oben) zu senden.